(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-101509

(43)公開日 平成8年(1996)4月16日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示簡用
G 0 3 F	7/039	501				
	7/004	501				
•	4.	503				
H01L	21/027			• •		· · ·
				H01L	21/30 502	R
				永龍査審	未請求 請求項の数2	FD (全 9 頁)
(21)出願番号		特願平6-261054		(71)出願人	000229117	
					日本ゼオン株式会社	
(22)出顧日	*	平成6年(1994)9)	月30日 -		東京都千代田区丸の内	2丁月6番1号
*			* · ·	(72)発明者	松野修吾	
					神奈川県川崎市川崎区	皮米―T日2乗1号
-					日本ゼオン株式会社	
				(72)発明者	阿部信紀	
	-	•	:		神奈川県川崎市川崎区	本米―T日り乗1日
- ,					日本ゼオン株式会社	
		•		(72)発明者	和田 泰昌	7
,				(1-) JE 7. FA	神奈川県川崎市川崎区	水半二丁戸り乗り早
					日本ゼオン株式会社	
4.	•*		* * * *		ロサビオン外及芸化	rs
						••

(54) 【発明の名称】 レジスト組成物

(57)【要約】

【目的】 新規な感放射線性レジスト組成物を提供する。

【構成】 (置換可) アクリル酸の1ーアルキルシクロアルキルエステル単位のほかに、他の(置換可) アクリル酸エステル単位や置換可スチレン単位を有する重合体と活性化放射線の照射により酸を発生する放射線感応性成分を含むことを特徴とするレジスト組成物。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)、(2)および(3) 【化1】

$$R^{1}$$
 R^{4}
 R^{8}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}

【化2】

$$\mathbb{R}^2$$
 \mathbb{R}^6
 \mathbb{R}^5

【化3】

$$R^3$$
 CO_2R^7

(式 (1) \sim (3) 中、 $R^1\sim R^3$ はそれぞれ独立に水素 原子、炭素数1~4の置換可アルキル基、ハロゲン原 子、シアノ基、ニトロ基であり、R⁴は直鎖、分岐また は環状の炭素数1~8の置換可アルキル基、置換可アル ケニル基であり、 R^5 と R^6 はそれぞれ独立して水素原 子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、水酸基、カル ボキシル基、直鎖、分岐または環状の炭素数1~8の置 換可アルキル基、直鎖、分岐または環状の炭素数1~8 40 の置換可アルコキシ基、炭素数6~12の置換可アリー ル基、炭素数7~14の置換可アラルキル基であり、R 7 は直鎖、分岐または環状の炭素数 $1\sim$ 8の置換可アル キル基、直鎖、分岐または環状の炭素数1~8の置換可 アルケニル基である。 $R^8\sim R^{11}$ は、水素原子、ハロゲ ン原子、炭素数 $1\sim4$ の置換可アルキル基であり、少な くとも一つは水素原子である。Aは単結合または二価の 置換可有機基である。式(1)、(2)、(3)で表さ れる単位の比率はそれぞれk、m、nで表され、k+m

である。)で表される構成単位を有する重合体と活性化 放射線の照射により酸を発生する放射線感応性成分を含 むことを特徴とするレジスト組成物。

【請求項2】 更に低分子フェノール誘導体を含有する 請求項1記載のレジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、感放射線組成物に関し、さらに詳しくは、エキシマレーザーなどの遠紫外

10 線、X線、電子線などの荷電粒子線といった放射線を用いる半導体素子の超微細加工に有用なレジストとして好適な感放射線性組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体素子を製造する場合、シリコンウエハ表面にレジストを塗布して感光膜をつくり、光を照射して潜像を形成し、ついでそれを現像してネガまたはポジの画像を形成するリソグラフィー技術に依って画像を得ている。ところで、IC、LSI、さらにVLSIへと半導体の高集積化、高密度化、小型化に伴って0.

20 5μ以下の微細パターンを形成する技術が要求されている。しかしながら近紫外線、可視光線を用いる従来のリソグラフィーでは精度よく、0.5μm以下の微細パターンを形成することはきわめて困難であり、歩留りの低下も著しい。このため、波長350~450nmの近紫外線光を利用する従来のフォトリソグラフィーに替えて、露光の解像度を高めるために、波長の短い遠紫外線(短波長紫外線)、クリプトンフルオライドレーザー(KrFエキシマレーザー光;波長248nm)や電子線などを用いるリソグラフィー技術が研究されている。

30 従来の近紫外線光を利用するリソグラフィーには、基材 髙分子としてノボラック樹脂が使用されているが、該樹 脂は波長350~450nmの紫外線光に対する透過率 は良好なものの、それより短波長の遠紫外線やKrFエ キシマレーザー光に対しては透過率が極端に悪化するた め、基材高分子として該樹脂を使用した場合には、充分 な感度が得られない、パターン形状が悪いといった問題 点が知られている。透過率の悪さを改良する目的で、基 材髙分子としてポリビニルフェノール誘導体を用いる化 学増幅系レジストが検討されている(特公平2-276 60号公報)が、それでもパターン形状が要求を満足さ せるには至っていない。また、最近の例として、より透 過率を向上させることを目的とした水素添加ポリビニル フェノール誘導体を基材高分子として用いる方法(特開 平5-249673号公報など)が知られている。この 改良によりパターン形状はだいぶ改善されたものの、よ り高度化しているレジストの要求特性、とくに解像性に 対しては、更なる改善が求められている。

[0003]

4 いる単位の比率はそれぞれ k、 m、 n で表され、 k+m 【発明が解決しようとする課題】かかる従来技術のもと +n=1 であり、 $0 < k \le 1$ 、 $0 \le m < 1$ 、 $0 \le n < 1$ 50 で、発明者らは、前記の問題を解決すべく鋭意研究した

結果、(置換可)アクリル酸の1-アルキルシクロアルキルエステル単位のほかに、他の(置換可)アクリル酸エステル単位や置換可スチレン単位を有する樹脂を用いるとレジスト特性に優れたレジスト組成物が得られることを見いだし、この知見に基づき本発明を完成するに到った。

[0004]

【課題を解決するための手段】かくして、本発明によれば、一般式(1)、(2)および(3) 【化4】

$$\begin{array}{c|c}
R^1 \\
\hline
 & R^4 R^8 R^9 \\
\hline
 & CO_2 & C \\
\hline
 & R^{10} C \\
\hline
 & R^{11} & A
\end{array}$$
(1)

【化5】

$$\mathbb{R}^{2}$$
 \mathbb{R}^{6}
 \mathbb{R}^{5}

[化6]

$$R^3$$
 CO_2R^7

(式 (1) \sim (3) 中、 $R^1\sim R^3$ はそれぞれ独立に水素 40 原子、炭素数 $1\sim 4$ の置換可アルキル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基であり、 R^4 は直鎖、分岐または環状の炭素数 $1\sim 8$ の置換可アルキル基、置換可アルケニル基であり、 R^5 と R^6 はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、水酸基、カルボキシル基、直鎖、分岐または環状の炭素数 $1\sim 8$ の置換可アルコキシ基、炭素数 $6\sim 1$ 2の置換可アリール基、炭素数 $7\sim 1$ 4の置換可アラルキル基であり、 R^7 は直鎖、分岐または環状の炭素数 $1\sim 8$ の置換可アル

キル基、直鎖、分岐または環状の炭素数 1~8の置換可アルケニル基である。R8~R¹¹は、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1~4の置換可アルキル基であり、少なくとも一つは水素原子である。Aは単結合または二価の置換可有機基である。式(1)、(2)、(3)で表される単位の比率はそれぞれk、m、nで表され、k+m+n=1であり、0<k≤1、0≤m<1、0≤n<1である。)で表される構成単位を有する重合体と活性か放射線の照射により酸を発生する放射線感応性成分を含10 むことを特徴とするレジスト組成物が提供される。

【0005】以下、本発明について詳述する。本発明で 用いられる樹脂は、前記式(1)~(3)で表される構 成単位を有する重合体である。この重合体が共重合体で ある場合、ブロック共重合体であってもランダム共重合 体であってもよい。この重合体の重合平均分子量は、下 限が通常1,000、好ましくは2,000であり、上 限は通常100、000、好ましくは20、000であ る。分子量が低いとレジスト膜の機械的強度が弱くな り、逆に分子量が高いと粘度が高くなり均一なレジスト 20 膜が得難くなる傾向がある。式 (1)~(3) において $R^{1} \sim R^{3}$ の具体例としては、水素原子;メチル基、エチ ル基 n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル 基、s - ブチル基、t - ブチル基などの炭素数1~4の アルキル基やこれらのアルキル基のひとつ以上の水素原 子がハロゲン原子、アルコキシ基等で置換された置換 体;フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子; シアノ基;ニトロ基が挙げられる。式(1)のR4は、 メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル 基、nーブチル基、sーブチル基、tーブチル基、ペン 30 チル基、イソペンチル基、ヘキシル基、1-エチルブチ ル基、4ーメチルペンチル基、ヘプチル基、1ーメチル ペンチル基、4-メチルヘキシル基、3,3-ジメチル ペンチル基、オクチル基、1-エチルヘキシル基、シク ロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基 シクロオクチル基、2-メトキシエチル基、2-エトキ シエチル基、クロロメチル基、2-クロロエチル基、2 ーメチルシクロペンチル基、5ーメトキシペンチル基、 3, 3-ジクロロシクロオクチル基などの直鎖、分岐ま たは環状の炭素数1~8のアルキル基やこれらのアルキ ル基のひとつ以上の水素原子がハロゲン原子やアルコキ シ基などで置換された置換体:ビニル基、1-プロペニ ル基、1ーブテン-1ーイル基、1ーブテン-2-イル・ 基 2ープテン-2ーイル基 1ーペンテン-2イル 基、2-ヘキセン-2-イル基、3-ヘプテン-3-イ ル基、1-オクテンー6-イル基などの直鎖、分岐また は環状の炭素数1~8の置換可アルケニル基が挙げられ

【0006】式(2)のR⁵とR⁶はそれぞれ独立して水 素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、水酸基、 カルボキシル基、前記のような直鎖、分岐または環状の

01

20

炭素数1~8の置換可アルキル基;メトキシ基、エトキ シ基、nープロポキシ基、イソプロポキシ基、nーブト キシ基、sーブトキシ基・tーブトキシ基、ペントキシ 基、イソペントキシ基、ヘキシルオキシ基、1-エトキ・ シブトキシ基 4-メチルペントキシ基 ヘプトキシ 基、1-メチルペントキシ基、4-メチルヘキシル基。 3. 3-ジメチルペントキシ基、オクトキシ基、1-エ チルヘキシル基、シクロペントキシ基、シクロヘキシル オキシ基、シクロヘプトキシ基、シクロオクトキシ基、 2-メトキシエトキシ基、2-エトキシエトキシ基、ク ロロメトキシ基 2-クロロエトキシ基 2-メチルシ クロペントキシ基、5-メトキシペントキシ基、3,3 ージクロロシクロオクトキシ基などの直鎖、分岐または 環状の炭素数1~8のアルコキシ基やこれらのアルコキ シ基のひとつ以上の水素原子がハロゲン原子やアルコキ シ基などで置換された炭素数1~8の置換可アルコキシ 基のほか、フェニル基、4-メチルフェニル基、2,4 - ジメチルフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、 4-メトキシフェニル基、ナフチル基などの炭素数6~ 12の置換可アリール基;ベンジル基、フェネチル基、 4-メチルベンジル基、3-クロロフェネチル基、2-メチルナフチル基などの炭素数7~14の置換可アラル キル基などが挙げられる。中でも水酸基などは基板に対 する密着性が向上するため好ましい例である。式 (3) のR⁷は前記のような直鎖、分岐または環状の炭素数1 ~8の置換可アルキル基や前記のような直鎖、分岐また は環状の炭素数1~8の置換可アルケニル基である。式 (1) R8~R11は、水素原子、ハロゲン原子、前記の ような炭素数1~4の置換可アルキル基であるが、この うち少なくとも一つは水素原子である。水素原子が一つ 30 以上ないと、酸不安定性基として機能しなくなり、水素 原子が多いほど酸により切断され易くなるので好まし い。式(1)のAは単結合または二価の置換可有機基で ある。ここでいう二価の置換可有機基の具体例として は、-CH2-、-C2H4-、-C3H6-、-C4H 8-、 $-C_5H_{10}-$ のような $-C_nH_{2n}-$ で表されるアル キレンやこれらの水素原子の一部または全部がハロゲン 原子、シアノ基、水酸基、炭素数1~4のアルキル基、 炭素数1~4のアルコキシ基、炭素数2~5のアルケニ ル基で置換された-CHC1-、-CH2C(CN)H -, -C (CH₃) H-, -CH₂C (CH₃) H-, -CH2C (CH3) HCH2-, -C (OCH3) H-, -CH (CH=CH2) CH2-などの置換可アルキレン; -CH=CH-, -C $(CH_3)=CH-CH_2-$, -C(CH₃) = CHC1-など置換可アルケニレンなどの 二価の置換可有機基である。このような有機基の炭素数 は、置換基として結合するシアノ基、アルキル基、アル ケニル基由来の炭素以外の炭素数で通常1~5、好まし くは3または4である。

[0007]式(1)、(2)、(3)で表される構成 50

単位の樹脂中での割合はk、m、nで表され、k+m+ n=1, $0 \le k \le 1$, $0 \le m \le 1$, $0 \le n \le 1$ cbsoloning. すなわち式(1)で表される構成単位のみの重合体であ ってもよいが、式(1)で表される構成単位を含まない 重合体では本発明の目的を達成しない。従って、式

(1)で表される構成単位の割合kは通常0<k≤1、 好ましくは $0.2 \le k \le 1$ 、より好ましくは $0.4 \le k$ ≤1 である。

【0008】本発明で樹脂成分として用いられる前記式 (1)~(3)で表される構成単位を有する重合体は、 常法に従って合成される。例えば、各式で表される構成 単位を与える単量体を所望の割合で混合して重合する方 法、式(1)または式(2)式(2)の構成単位を与え る単量体とアクリレート類とを重合したのち、式(1) の R^4 や式(3)の R^7 を導入する方法などがある。ま た、得られた重合体を部分水素添加したものも本発明で 用いることができる。前記式(1)の構成単位を与える 単量体の具体例としては、1-メチルシクロペンチル アクリレート、1-メチルシクロヘキシル アクリレー ト、1-エチルシクロペンチル アクリレート、1-エ チルシクロヘキシル アクリレート、1ーメチルシクロ ヘプチル アクリレート、1ープロピルシクロヘプチル アクリレート、1-メチルシクロオクチル アクリレ ート、1-メチルシクロペンチル メタクリレート、1 ーメチルシクロヘキシル メタクリレート、1ーエチル シクロペンチル メタクリレート、1-エチルシクロへ キシル メタクリレート、1ーメチルシクロヘプチル メタクリレート、1ープロピルシクロヘプチルメタクリ レート、1-メチルシクロオクチル メタクリレートな どの置換可アクリル酸の1-アルキルシクロアルキルエ ステル化合物が挙げられる。前記式(2)の構造単位を 与える単量体の具体例としては、スチレン、4-メチル・ スチレン、4-ヒドロキシスチレン、3-ヒドロキシス チレン、2-ヒドロキシスチレン、4-カルボキシスチ レン、3-カルボキシスチレン、2-カルボキシスチレ ン、4-二トロスチレン、3-二トロスチレン、2-二 トロスチレン、2,4-ジメチルスチレン、2-メチル -4-ヒドロキシスチレン、3-メチル-4-ヒドロキ シスチレン、4-クロロスチレン、4-(クロロメチ ル) スチレン、4-メトキシスチレン、3-メトキシス チレン、2-メトキシスチレン、4-t-ブトキシスチ レン、3-t-ブトキシスチレン、2-t-ブトキシス チレンなどの置換可スチレン化合物や同様のαーメチル スチレン誘導体が挙げられる。

[0009] 前記式(3)の構成単位を与えるモノマー 成分の具体例としては、メチル アクリレート、エチル アクリレート、イソプロピル アクリレート、モーブ チルアクリレート、 t ーアミル アクリレート、シクロ ヘキシル アクリレート、アダマンチル アクリレー ト、メチル メタクリレート、エチル メタクリレー

ト、イソプロピル メタクリレート、tーブチル メタクリレート、tーアミルメタクリレート、シクロヘキシル メタクリレート、アダマンチル メタクリレートなどの置換可アクリル酸エステル類が例示される。

【0010】本発明で用いる樹脂の具体例としては、ポ リ(1-メチルシクロヘキシル(メタ)アクリレー ト)、ポリ(1-メチルシクロペンチル(メタ)アクリ レート)、1-メチルシクロヘキシル(メタ)アクリレ ート/スチレンコポリマー、1 - メチルシクロペンチル (メタ) アクリレート/4-ヒドロキシスチレンコポリ マー、1-メチルシクロヘキシル(メタ)アクリレート **/メチル** メタクリレートコポリマー、1-メチルシク ロヘキシル メタクリレート/アダマンチル メタクリ レートコポリマー、1-メチルシクロヘキシル・メタク リレート/4 - ヒドロキシスチレン/アダマンチル メ タクリレートコポリマー、1-エチルシクロペンチル (メタ) アクリレート/4-ヒドロキシスチレンコポリ マー、1-プロピルシクロペンチル(メタ)アクリレー ト/4-ヒドロキシスチレンコポリマー、1-メチルシ クロペンチル (メタ) アクリレート/4ーヒドロキシス チレン/エチル メタクリレートコポリマー、1-メチ ルシクロヘキシル (メタ) アクリレート/4ーヒドロキ シスチレンコポリマー/ビニル(メタ)アクリレートコ ポリマー、1-エチルシクロヘプチル(メタ)アクリレ ート/2-メチル-4-ヒドロキシスチレン/t-ブチ ル(メタ)アクリレートコポリマーなどが例示される。 【0011】本発明において用いられる酸発生剤(以 下、PAGという)は、活性化放射線に露光されるとブ レンステッド酸またはルイス酸を発生する物質であれば 特に制限はなく、オニウム塩、ハロゲン化有機化合物、 キノンジアジド化合物、α, αビス(スルホニル)ジア ソメタン系化合物、α-カルボニル-α-スルホニルジ アゾメタン系化合物、スルホン化合物、有機酸エステル 化合物、有機酸アミド化合物、有機酸イミド化合物など 公知のものを用いることができる。オニウム塩として は、ジアソニウム塩、アンモニウム塩、ジフェニルヨー ドニウムトリフレートなどのヨードニウム塩、トリフェ ニルスルホニウムトリフレートなどのスルホニウム塩、 ホスホニウム塩、アルソニウム塩、オキソニウム塩など が挙げられる。

【0012】ハロゲン化有機化合物としては、ハロゲン含有オキサジアゾール系化合物、ハロゲン含有トリアジン系化合物、ハロゲン含有アセトフェノン系化合物、ハロゲン含有ベンゾフェノン系化合物、ハロゲン含有スルホキサイド系化合物、ハロゲン含有チアゾール系化合物、ハロゲン含有オキサゾール系化合物、ハロゲン含有トリアゾール化合物、ハロゲン含有2ーピロン系化合物、その他ハロゲン含有ヘテロ環状化合物、ハロゲン含有脂肪族炭化水素化合物、ハロゲン含有芳香族炭化水素化合物、スルフェニルハラ

8

イド化合物などが挙げられ、具体的には、トリス(2, 3-ジブロモプロピル)ホスフェート、トリス(2,3 -ジブロモ-3-クロロプロピル)ホスフェート、テト ラブロモクロロブタン、ヘキサクロロベンゼン、ヘキサ ブロモベンゼン、ヘキサブロモシクロドデカン、ヘキサ ブロモビフェニル、アリルトリブロモフェニルエーテ ル、テトラクロロビスフェノールA、テトラブロモビス フェノールA、テトラクロロビスフェノールAのビス (クロロエチル) エーテル、テトラブロモビスフェノー ルAのビス(ブロモエチル)エーテル、ビスフェノール Aのビス(2,3-ジクロロプロピル)エーテル、ビス フェノールAのビス(2, 3ージブロモプロピル)エー テル、テトラクロロビスフェノールAのビス(2, 3-ジクロロプロピル) エーテル、テトラブロモビスフェノ ールAのビス (2, 3 – ジブロモプロピル) エーテル、 テトラクロロビスフェノールS、テトラブロモビスフェ ノールS、テトラクロロビスフェノールSのビス(クロ ロエチル) エーテル、テトラブロモビスフェノールSの ビス (ブロモエチル) エーテル、ビスフェノールSのビ ス (2, 3-ジクロロプロピル) エーテル、ビスフェノ ールSのビス (2, 3ージブロモプロピル) エーテル、 トリス(2,3-ジブロモプロピル)イソシアヌレー ト、2, 2-ビス(4-ヒドロキシー3, 5-ジプロモ フェニル) プロパン、2, 2ービス(4ー(2ーヒドロ キシエトキシ) -3, 5-ジブロモフェニル)プロパン などのハロゲン系難燃剤やジクロロジフェニルトリクロ ロエタン、ペンタクロロフェノール、2,4,6ートリ クロロフェニル 4-ニトロフェニルエーテル、2,4 ージクロロフェニル 3'ーメトキシー4'ーニトロフ ェニルエーテル、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸、 4, 5, 6, 7ーテトラクロロフタリド、1, 1ービス (4-クロロフェニル) エタノール、1, 1-ビス(4 ークロロフェニル) -2, 2, 2-トリクロロエタノー ル、2,4,4',5ーテトラクロロジフェニルスルフ ィド、2,4,4',5ーテトラクロロジフェニルスル ホンなどの有機クロロ系農薬などが例示される。

【0013】キノンジアジド化合物の具体例としては、
1,2ーベンゾキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、2,1ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、2,1ーベンゾキノンジアジドー5ースルホン酸エステル、2,1ーベンゾキノンジアジドー5ースルホン酸エステルのようなキノンジアジド誘導体のスルホン酸エステルや1,2ーベンゾキノンー2ージアジドー4ースルホン酸クロライド、1,2ーナフトキノンー2ージアジドー5ースルホン酸クロライド、1,2ーナフトキノンー1ージアジドー6ースルホン酸クロライド、1,2ーナフトキノンー1ージアジドー6ースルホン酸クロライド、1,2ーボンゾキノンー1ージアジドのカロライド、1,2ーベンゾキノンー1ージアジド

用いてもよい。

のスルホン酸クロライドなどが挙げられる。

【0014】α, αビス (スルホニル) ジアゾメタン系 化合物としては、未置換、対称的にまたは非対称的に置 換されたアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、芳 香族基、またはヘテロ環状基を有するα, αビス (スル ホニル) ジアソメタンなどが挙げられる。 α ーカルボニ ルーαースルホニルジアゾメタン系化合物の具体例とし ては、未置換、対称的にまたは非対称的に置換されたア ルキル基、アルケニル基、アラルキル基、芳香族基、ま たはヘテロ環状基を有するαーカルボニルーαースルホ ニルジアゾメタンなどが挙げられる。スルホン化合物の 具体例としては、未置換、対称的にまたは非対称的に置 換されたアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、芳 香族基、またはヘテロ環状基を有するスルホン化合物 (例えばジフェニルスルホン、ジニトリルスルホン、 4,4'ージメチルスルホン等)、ジスルホン化合物 (ジフェニルスルホン、ジ (フェニルスルホン) メタン 等)などが挙げられる。

【0015】有機酸エステルとしては、カルボン酸エステル、ハイドロキノンモノトシレートなどのスルホン酸 20 エステル、ホスホン酸エステルなどが挙げられ、有機酸アミドとしては、カルボン酸アミド、スルホン酸アミド、ホスホン酸アミドなどが挙げられ、有機酸イミドとしては、カルボン酸イミド、スルホン酸イミド、ホスホン酸イミドなどが挙げられる。

【0016】これらのPAGは、単独で使用しても2種類以上を混合して用いてもよい。これらのPAGの配合量は、本発明で用いる樹脂100重量部に対して下限は通常0.01重量部、好ましくは0.2重量部であり、上限は通常50重量部、好ましくは30重量部である。0.01重量部未満ではパターンの形成が不可能となり。50重量部を超えると現像残が発生し易くなったり、パターン形状が悪化するなどの問題が生じ、いずれの場合もレジストの性能上好ましくない。

【0017】本発明に於て、前記樹脂とPAGとからな るレジスト組成物は、溶剤に溶解させて用いる。溶剤 は、一般にレジスト組成物用の溶剤として使用されてい るものを用いることができ、具体例としては、アセト ン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、シクロペ ンタノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノンなどの 40 ケトン類;n-プロパノール、i-プロパノール、n-ブタノール、iーブタノール、tーブタノール、シクロ ヘキサノールなどのアルコール類: エチレングリコール ジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテ ル、ジオキサンなどのエーテル類;エチレングリコール ジメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエー テル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロ ピレングリコールモノエチルエーテルなどのアルコール エーテル類;ギ酸プロピル、ギ酸ブチル、酢酸プロピ ル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エ 50

チル、酪酸メチル、酪酸エチルなどのエステル類;2-オキシプロピオン酸メチル、2-オキシプロピオン酸エ チル、2-メトキシプロピオン酸メチル、2-メトキシ プロピオン酸エチルなどのオキシカルボン酸エステル 類;セロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテー ト、エチルセロソルブアセテート、プロピルセロソルブ アセテート、ブチルセロソルブアセテートなどのセロソ ルブエステル類;プロピレングリコール、プロピレング リコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレング リコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレング リコールモノブチルエーテルなどのプロピレングリコー ル類;ジエチレンギリコールモノメチルエーテル、ジエ チレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリ コールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチ ルエーテルなどのジエチレングリコール類:トリクロロ エチレンなどのハロゲン化炭化水素類;トルエン、キシ レンなどの芳香族炭化水素類; N, N-ジメチルホルム アミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルア セトアミド、Nーメチルピロリドンなどの極性溶媒など が例示され、これらは単独または2種類以上を混合して

10

【0018】本発明においては、添加剤としてレジスト 組成物に一般に添加されているもの、例えば界面活性 剤、保存安定剤、増感剤、ストリエーション防止剤、低 分子フェノール化合物誘導体など相溶性のある添加剤を 、含有させることができる。 低分子フェノール化合物の具 体例としては、pーフェニルフェノール、pーイソプロ ピルフェノール等のモノフェノール類;ビフェノール、 4, 4'ージヒドロキシジフェニルエーテル、4, 4' -ジヒドロキシベンゾフェノン、ビスフェノールA(本 州化学工業社製)、ビスフェノールC(本州化学工業社 製)、ビスフェノールE(本州化学工業社製)、ビスフ エノールF(本州化学工業社製)、ビスフェノールAP (本州化学工業社製)、ビスフェノールM (三井石油化 学工業社製)、ビスフェノールP(三井石油化学工業社 製)、ビスフェノールZ(本州化学工業社製)、1,1 ービス(4 ーヒドロキシフェニル)シクロペンタン、 9, 9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、 1, 1ービス(5ーメチルー2ーヒドロキシフェニル) メタン、3,5ージメチルー4ーヒドロキシベンジルフ ェノール等のビスフェノール類; 1, 1, 1ートリス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、1, 1, 1-トリ ス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1-ビス (3-メチルー4-ヒドロキシフェニル) -1- (4-ヒドロキシフェニル)メタン、1、1-ビス(2.5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル) -1-(2-ヒド ロキシフェニル)メタン、1,1ービス(3,5ージメ チルー4ーヒドロキシフェニル) -1- (2-ヒドロキ シフェニル) メタン、2, 6-ピス(5-メチルー2-ヒドロキシベンジル) -4-メチルフェノール、2,6

11 ービス(4 ーヒドロキシベンジル)-4 -メチルフェノ ール、2,6ービス(3ーメチルー4ーヒドロキシベン ジル) -4-メチルフェノール、2,6-ビス(3,5 **-ジメチル-4-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフ** ェノール、トリスフェノール-PA(本州化学工業社 製)、トリスフェノールーTC(本州化学工業社製)等 のトリスフェノール類;1,1,2,2-テトラキス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 1, 2, 2-テトラキス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)エ タン、1, 1, 3, 3-(4-ヒドロキシフェニル)プ 10 ロパン、1, 1, 5, 5ーテトラキス(4ーヒドロキシ フェニル) ペンタンlpha,lpha,lpha',lpha' ーテトラキス $(4-ヒドロキシフェニル) -3-キシレン、<math>\alpha$, α , α' , α' - \mathcal{F} F F 4 ーキシレン、 α , α , α' , α' ーテトラキス(3 ー メチルー4ーヒドロキシフェニル)-3ーキシレン、 α , α , α' , α' - γ - ドロキシフェニル) -4-キシレン等のテトラキスフェ ノール類などが例示される。このような低分子フェノー ル化合物の添加量は、前記重合体の組成、分子量、分子 20 量分布、他の添加剤の種類や量によりことなるが、重合 体100重量部に対して、上限は通常100重量部、好 ましくは60重量部、下限は通常0重量部、好ましくは 3 重量部である。このような低分子フェノール化合物を 添加すると感度、解像性、密着性等の特性を向上させる ことができる。

【0019】本発明の組成物において、前記式(1)で表される構成単位を有する重合体は、放射線の照射により酸発生剤から生成する酸の作用を受けて、被照射部分の溶解度が変化する。本発明の組成物は、アルカリ現像 30液を用いることにより、ポジ型レジストとして作用する。

【0020】本発明のレジスト組成物はアルカリ現像液 として通常、アルカリ水溶液を用いるが、具体例として は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸ナトリ ウム、アンモニアなどの無機アルカリの水溶液;エチル アミン、プロピルアミンなどの第一アミン類の水溶液; ジエチルアミン、ジプロピルアミンなどの第二アミンの 水溶液;トリメチルアミン、トリエチルアミンなどの第 三アミンの水溶液;ジエチルエタノールアミン、トリエ 40 タノールアミンなどのアルコールアミン類の水溶液;テ トラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルア ンモニウムヒドロキシド、トリメチルヒドロキシメチル アンモニウムヒドロキシド、トリエチルヒドロキシメチ ルアンモニウムヒドロキシド、トリメチルヒドロキシエ チルアンモニウムヒドロキシドなどの第四級アンモニウ ムヒドロキシドの水溶液などが挙げられる。また、必要 に応じて、上記アルカリ水溶液にメタノール、エタノー ル、プロパノール、エチレングリコールなどの水溶性有 機溶媒、界面活性剤、樹脂の溶解抑止剤などを添加する 50

ことができる。

【0021】本発明のレジスト組成物を溶剤に溶解させたレジスト溶液をシリコンウエハなどの基板表面に常法により塗布した後、溶剤を乾燥除去することによりレジスト膜を形成することができる。このときの塗布方法としては、特にスピンコーティングが賞用される。このようにして得られたレジスト膜にパターンを形成させるための露光で用いられる露光源としては遠紫外線、KrFエキシマレーザー光、X線、電子線などの電子線源が挙げられる。更に、露光後に熱処理(露光後ベーク)を行うと、感度の向上と安定化が図れるため好ましい。【0022】

12

【実施例】以下に参考例、合成例、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。なお、各例中の部及び%は、特に断りのない限り重量基準である。

【0023】(合成例1)ポリ(1-メチルシクロヘキシル メタクリレート)

1ーメチルシクロヘキシル メタクリレート182.3 g (1.00mol)、アソビスイソブチロニトリル8.2g (0.05mol)、ジオキサン300mlを1リットルフラスコに仕込み 窒素気流下、80℃で5時間攪拌を行った。得られた反応液を10リットルのメタノールに投入し、生じた沈澱物を濾過した。得られた固形分をジエチルエーテル400mlに溶解させ、10リットルのメタノールに投入し、生じた沈澱物を濾過した(再沈操作)。この再沈操作を2回繰り返した後、乾燥し、163.9gの重合体を得た。この重合体は、GPC分析の結果、Mw=8,860であった。

[0024] (合成例2) ポリ (1ーメチルシクロペンチル メタクリレート)

1-メチルシクロヘキシル メタクリレートの代わりに 1-メチルシクロペンチル メタクリレート168.2 g(1.00mol)を使用した以外は、合成例1と同様の方法で153.6gの重合体を得た。この重合体は、GPC分析の結果、Mw=8,030であった。【0025】(合成例3)1-メチルシクロヘキシル

メタクリレート/スチレン コポリマースチレン59.4g(0.57mol)、1ーメチルシクロヘキシル メタクリレート72.9g(0.40mol)、アゾビスイソブチロニトリル8.2g(0.05mol)、ジオキサン250mlを1リットルフラスコに仕込み、窒素気流下、80℃で5時間攪拌を行った。得られた反応液を10リットルのメタノールに投入し、生じた沈澱物を濾過した。得られた固形分をジエチルエーテル300mlに溶解させ、10リットルのメタノールに投入し、生じた沈澱物を濾過した(再沈操作)。この再沈操作を2回繰り返した後、乾燥し、8

3. 3gの重合体を得た。この重合体は、GPC分析の結果、Mw=6, 920であった。また、 ^1H-NMR より1-メチルシクロヘキシル メタクリレート/スチ

レンの重合比率は48/52であった。

【0026】(合成例4)1-メチルシクロペンチル メタクリレート/4ーヒドロキシスチレン 4-ヒドロシキスチレン36.6g(0.30mo 1)、1-メチルシクロペンチル メタクリレート2 0. 2g(0.12mol)、アゾビスイソブチロニト リル1. 0g(0.006mol)、ジオキサン100 m1を500m1フラスコに仕込み、窒素気流下、80 ℃で15時間攪拌を行った。得られた反応液を8リット ルのトルエンに投入し、生じた沈澱物を濾過した。得ら れた固形分をジエチルエーテル80m1に溶解させ、5 リットルのn-ヘキサンに投入し、生じた沈澱物を濾過 した (再沈操作)。この再沈操作を3回繰り返した後、 乾燥し、34.1gの重合体を得た。この重合体は、G PC分析の結果、Mw=4, 960であった。また、1 H-NMRより1-メチルシクロペンチル メタクリレ ート/4-ヒドロキシスチレンの重合比率は46/54 であった。

【0027】(合成例5)1-メチルシクロヘキシル メタクリレート/メチル メタクリレート コポリマー 1-メチルシクロヘキシル メタクリレート182.3 gを1ーメチルシクロヘキシル メタクリレート10 0. 2g(0.55mol)とメチル メタクリレート・ 45. 1g(0.45mol)に代えるほかは、合成例 1と同様の方法により134.4gの重合体を得た。こ の重合体は、GPC分析の結果、Mw=6,550であ った。また、¹H-NMRより1-メチルシクロヘキシ ル メタクリレート/メチル メタクリレートの重合比 率は51/49であった。

【0028】(合成例6)1-メチルシクロヘキシル メタクリレート/アダマンチル メタクリレート コポ

1-メチルシクロヘキシル メタクリレート45.5g (0.25mol)、アダマンチル メタクリレート5 5. 0g(0.25mol)、アゾビスイソブチロニト リル1. 7g(0.01mol)、ジオキサン100m 1を1リットルフラスコに仕込み、窒素気流下、80℃ で5時間攪拌を行った。得られた反応液を10リットル のnーヘキサンに投入し、生じた沈澱物を濾過した。得 られた固形分をジエチルエーテル400mlに溶解さ せ、7リットルのnーヘキサンに投入し、生じた沈澱物 を濾過した(再沈操作)。この再沈操作を3回繰り返し た後、乾燥し、90.5gの重合体を得た。この重合体 は、GPC分析の結果、Mw=6,890であった。ま た、¹H-NMRより1-メチルシクロヘキシル メタ クリレート/アダマンチル メタクリレートの重合比率 は54/46であった。

【0029】(合成例7)1-メチルシクロヘキシル メタクリレート/4ーヒドロキシスチレン/アダマンチ ル メタクリレート コポリマー

4-ヒドロシキスチレン60g(0.50mol)、1 ーメチルシクロヘキシル メタクリレート60.1g (0.33mol)、アダマンチル メタクリレート2 4. 9g(0.22mol)、アゾビスイソブチロニト リル1. 7g(0.01mol)、ジオキサン200m 1を1リットルフラスコに仕込み、窒素気流下、80℃ で15時間攪拌を行った。得られた反応液を15リット ルのキシレンに投入し、生じた沈澱物を濾過した。得ら れた固形分をジエチルエーテル200m1に溶解させ、 20リットルのn-ヘキサンに投入し、生じた沈澱物を 濾過した(再沈操作)。この再沈操作を3回繰り返した

14

後、乾燥し、83.5gの重合体を得た。この重合体 は、GPC分析の結果、Mw=5,670であった。ま た、 1 H-NMRより 1 ーメチルシクロヘキシル メタ クリレート/4ーヒドロキシスチレン/アダマンチル メタクリレートの重合比率は51/28/21であっ た。

【0030】(合成例8)1-エチルシクロヘキシル メタクリレート/4ーヒドロキシスチレン コポリマー 20 1ーメチルシクロヘキシル メタクリレートの代わりに 1-エチルシクロヘキシル メタクリレート29.4 g (0. 15mol) とする以外は合成例4と同様の方法 により34.1gの重合体を得た。この重合体は、GP C分析の結果、Mw=5, 470であった。また、 ^{1}H **-NMRより1-エチルシクロヘキシルメタクリレート** /4-ヒドロキシスチレンの重合比率は45/55であ

【0031】(参考例1)t-ブチル メタクリレート /4-ヒドロキシスチレン コポリマーの合成 30 1-メチルシクロヘキシル メタクリレートの代わりに tープチル メタクリレート14.2g(1.10mo 1)とする以外は合成例4と同様の方法により32.2 gの重合体を得た。この重合体は、GPC分析の結果、 Mw=4, 810 $rac{1}{3}$ $rac{1}$ $rac{1}$ $rac{1}{3}$ $rac{1}{3}$ $rac{1}{3}$ $rac{1}{3}$ $rac{1}{3}$ ープチル メタクリレート/4ーヒドロキシスチレンの 重合比率は42/58であった。

【0032】 (実施例1~8) 合成例1~8で得られた 重合体100部、光酸発生剤としてトリフェニルスルホ ニウム トリフレート5部 フッ素系界面活性剤0.0 1部を乳酸エチル440部に溶解させ、0.1 μmのポ リテトラフルオロエチレン製フィルター(ミリポア社 製)で濾過してレジスト溶液を調製した。このレジスト 溶液をシリコンウエハ上にスピンコートした後、9.0℃ で90秒間のベークを行うことにより膜厚1.0 µmの レジスト膜を形成した。このウエハをエキシマレーザー ステッパー(NA=0.45)とテストマスクを用いて 露光を行った。次いで、110℃で60秒間のベークを 行った後、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶 液で1分間の浸漬現像を行い、ポジ型パターンを得た。

これらのレジスト膜の感度と、露光の適性化により得ら

16

15 れた良好なパターンを示したときの解像性を表1に示

* [0033] 【表1】

		。 【塩合比】	这 度 pJ/ca²	深像性 μm
	1	ネ゚リ(1−メテルシクロヘ キシル、メタクリレート)	8	0. 30
	2	ポリ(1-メチルシクロペンチル メタクリレート)	10	0. 30
	3	1-45%970449% 4979b-6/25by [48/52]	23	0. 325
安	4	1-メチルジクロペ*ンチル メタクリレート/4-ヒト*ロキシスチレン [48/54]	12	0. 25
超	5	1-3589904498 39790-1/358 39790-1 [6 1 / 4 9]	1 7	0. 325
ਿ	в	1-メテルシクロヘキジル メタクリレート/ アラ・マンチル メタクリレート [54/46]	35	0. 35
,	7	1-メfbシクロヘキシみ メタクリレート/4-ヒト ロキンスチレン/ アタ・マッチる メタクリレート [61/28/21]	23	0. 275
	8	1-1467701478 19791-1/4-th 0477717 [4 6 / 6 5]	1 3	0. 25

【0034】(実施例9)合成例4で得られた重合体に ついて、光酸発生剤をジフェニルヨードニウムトリフレ ート5部として実施例4と同様の性能テストを行った。 この結果、感度は11mJ/cm²、解像度は0.25 μmであった。

【0035】 (実施例10) 合成例4で得られた重合体 について光酸発生剤をハイドロキノン モノトシレート 10部とし、露光後のベーク条件を110℃で60秒と する以外は実施例4と同様の性能テストを行った。この 結果、感度は34mJ/cm²、解像度は0.35μm であった。

【0036】(実施例11)実施例4で用いたレジスト 組成物に更にビスフェノールAを10部加える以外は、 実施例4と同様の性能テストを行った。この結果、感度 は $9mJ/cm^2$ 、解像度は 0.25μ mであった。

【0037】(実施例12)実施例4のレジスト材料を※

20%用いて、露光~ベークまでの時間を15分、30分、6 0分、120分と変化させてパターン形状を調べたが、 いずれの場合も良好なパターンが得られた。

【0038】 (比較例1)参考例1で得られた重合体に ついて、実施例4と同様にレジスト溶液を調製し、実施 例4と同様の性能テストを行った。この結果、感度は9 mJ/cm^2 、解像度は0.275 μ mであった。この レジスト材料を用い、露光~ベークまでの時間を15 分、30分、60分、120分と変化させてパターン形 状を調べたが、15分後には形状が若干劣化し、更に時 30 間を経るにつれ、劣化の度合が激しくなった。60分後 のものは、もはやパターンを形成できなかった。実施例 12と比較例1のデータを表2に示す。

[0039]

【表2】

	1 5	30	60	120
安旋例12のパターン形状	良好	良好	良好	わずかに劣化
比較例1のパターン形状	若干劣化	T-TPO形状	パターン 形成不能	同左

【0040】以上実施例1~11から、本発明の重合体 を用いると高い感度と解像性が得られ、また実施例12 や比較例1から本発明の重合体を含有するレジスト組成 物は安定性に優れていることが判った。

[0041]

【発明の効果】かくして本発明によれば、感度、解像

性、安定性などのレジスト特性に優れ、波長の短い遠紫 外線やKrFエキシマレーザー光を用いるリソグラフィ ーに適したレジスト材料が得られる。本発明のレジスト 組成物は、特に半導体素子の微細加工用ポジ型レジスト として好適である。